



本社：〒160-8366
東京都新宿区西新宿 6 丁目 24 番 1 号
西新宿三井ビルディング

報告書番号：PCN#20110901001
2011 年 9 月 8 日

お客様各位

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社
営業・技術本部 カスタムドキュメント
マネージャ 牧 達郎 (牧)

HVAL-SLL DBV/DCKパッケージ LVC LL製品 チップ一部改定のご案内

拝啓 貴社益々ご清栄の事とお喜び申し上げます。平素は弊社製品のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。さて、標題の件につきましてご連絡させていただきます。ご査収の程、宜しく願い申し上げます。

今回のお知らせは、変更実施についての連絡になります。変更の詳細は、次頁以降をご参照下さい。

お客様におかれましては、本通知発行日後、**30** 日以内に通知確認のご連絡をお願いいたします。また、30 日以内にご連絡が無い場合には、本変更をご承認いただいたものと判断させていただきます。変更品評価用サンプルもしくは追加データご入用の場合には、本通知発行日後 30 日以内にご依頼をお願いいたします。

変更品の出荷につきましては、お客様との早期変更実施の個別契約を締結している場合を除いては、本通知発行日より **90** 日以降に予定いたしております。この通知期間は、弊社品質標準に基づいております。

本通知は、いかなる製品の製造終了に関する状況を変更するものではありません。既に製造終了の連絡をさせていただいている場合には、本通知によって、既通知の最終受注日及び最終出荷日が延長されることはありません。

本通知は、通知日前 24 ヶ月以内に本変更対象製品をご購入いただいたお客様に連絡させていただきます。

尚、変更時期につきましては、在庫状況により異なりますので、担当営業にお問い合わせ下さい。また、ご不明な点、ご質問等がございましたら、担当営業或いはpcn_tij@list.ti.comにお問い合わせ下さい。

以上

変更概要

通知タイプ	☐ Initial notice (Plan)	☒ Final notice		
変更概要	☒ Design/Specification	☒ Design	☐ Electrical	☐ Mechanical
	Wafer Fab	☐ Site	☐ Process	☐ Material
	Wafer Bump	☐ Site	☐ Process	☐ Material
	Assembly	☐ Site	☐ Process	☐ Material
	Test	☐ Site	☐ Process	
	Others	☐ Packing/Shipping/Labeling ☐ -		
変更内容	HVAL-SLL DBV/DCKパッケージ LVC LL製品 チップ一部改定 現行 : チップレビジョン Rev A/D/E 変更後: チップレビジョン Rev G			
対象製品	対象製品リスト参照			
変更時期	12 月中旬の出荷より予定しています。			
品質認定試験	☐ 計画	☒ 終了		
製品表示	☐ 変更無し	☒ 変更あり		
備考	-			

変更内容

内容: 弊社 HVAL-SLL (汎用リニアロジック) DBV/DCKパッケージ LVC LL製品について、供給能力確保の為に、チップレビジョンを現行 Rev A/D/E からRev G にチップを一部改定します。データシート規格値に変更はありません。尚、今回の変更で、製品についての互換性(寸法/公差), 外観, 品質, 信頼性への影響はありません。

<u>変更内容</u>	<u>現行</u>	<u>変更後</u>
チップレビジョン	Revision A/D/E	Revision G

理由: 供給能力確保の為

対象製品リスト

対象製品名				
74LVC1GU04DBVRE4	SN74LVC1G02DCKRG4	SN74LVC1G07DBVRG4	SN74LVC1G14DBVTE4	SN74LVC1G32DCKR
74LVC1GU04DBVRG4	SN74LVC1G02DCKT	SN74LVC1G07DBVT	SN74LVC1G14DBVTG4	SN74LVC1G32DCKRE4
74LVC1GU04DBVTE4	SN74LVC1G02DCKTG4	SN74LVC1G07DBVTE4	SN74LVC1G14DCK3	SN74LVC1G32DCKRG4
74LVC1GU04DBVTG4	SN74LVC1G04DBVR	SN74LVC1G07DBVTG4	SN74LVC1G14DCKR	SN74LVC1G32DCKT
74LVC1GU04DCKRE4	SN74LVC1G04DBVRE4	SN74LVC1G07DCK3	SN74LVC1G14DCKRE4	SN74LVC1G32DCKTE4
74LVC1GU04DCKRG4	SN74LVC1G04DBVRG4	SN74LVC1G07DCK6	SN74LVC1G14DCKRG4	SN74LVC1G32DCKTG4
74LVC1GU04DCKTE4	SN74LVC1G04DBVT	SN74LVC1G07DCKR	SN74LVC1G14DCKT	SN74LVC1G34DBVR
74LVC1GU04DCKTG4	SN74LVC1G04DBVTE4	SN74LVC1G07DCKRE4	SN74LVC1G14DCKTE4	SN74LVC1G34DBVRE4
SN74LVC1G00DBV3	SN74LVC1G04DBVTG4	SN74LVC1G07DCKRG4	SN74LVC1G14DCKTG4	SN74LVC1G34DBVRG4
SN74LVC1G00DBVR	SN74LVC1G04DCK3	SN74LVC1G07DCKT	SN74LVC1G17DBV3	SN74LVC1G34DBVT
SN74LVC1G00DBVRE4	SN74LVC1G04DCKR	SN74LVC1G07DCKTE4	SN74LVC1G17DBVR	SN74LVC1G34DBVTE4
SN74LVC1G00DBVRG4	SN74LVC1G04DCKRE4	SN74LVC1G07DCKTG4	SN74LVC1G17DBVRE4	SN74LVC1G34DBVTG4
SN74LVC1G00DBVT	SN74LVC1G04DCKRG4	SN74LVC1G08DBVR	SN74LVC1G17DBVRG4	SN74LVC1G34DCKR
SN74LVC1G00DBVTG4	SN74LVC1G04DCKT	SN74LVC1G08DBVRE4	SN74LVC1G17DBVT	SN74LVC1G34DCKRE4
SN74LVC1G00DCK3	SN74LVC1G04DCKTE4	SN74LVC1G08DBVRG4	SN74LVC1G17DBVTE4	SN74LVC1G34DCKRG4
SN74LVC1G00DCKR	SN74LVC1G04DCKTG4	SN74LVC1G08DBVT	SN74LVC1G17DBVTG4	SN74LVC1G34DCKT
SN74LVC1G00DCKRE4	SN74LVC1G06DBVR	SN74LVC1G08DBVTE4	SN74LVC1G17DCK3	SN74LVC1G34DCKTG4
SN74LVC1G00DCKRG4	SN74LVC1G06DBVRE4	SN74LVC1G08DBVTG4	SN74LVC1G17DCKR	SN74LVC1G38DBVR
SN74LVC1G00DCKT	SN74LVC1G06DBVRG4	SN74LVC1G08DCK3	SN74LVC1G17DCKRE4	SN74LVC1G38DBVRE4
SN74LVC1G00DCKTE4	SN74LVC1G06DBVT	SN74LVC1G08DCK6	SN74LVC1G17DCKRG4	SN74LVC1G38DBVT
SN74LVC1G00DCKTG4	SN74LVC1G06DBVTE4	SN74LVC1G08DCKR	SN74LVC1G17DCKT	SN74LVC1G38DCKR
SN74LVC1G02DBVR	SN74LVC1G06DBVTG4	SN74LVC1G08DCKRE4	SN74LVC1G17DCKTE4	SN74LVC1G38DCKRE4
SN74LVC1G02DBVRE4	SN74LVC1G06DCKR	SN74LVC1G08DCKRG4	SN74LVC1G17DCKTG4	SN74LVC1G38DCKRG4
SN74LVC1G02DBVRG4	SN74LVC1G06DCKRE4	SN74LVC1G08DCKT	SN74LVC1G32DBVR	SN74LVC1G38DCKT
SN74LVC1G02DBVT	SN74LVC1G06DCKRG4	SN74LVC1G08DCKTE4	SN74LVC1G32DBVRE4	SN74LVC1GU04DBVR
SN74LVC1G02DBVTG4	SN74LVC1G06DCKT	SN74LVC1G08DCKTG4	SN74LVC1G32DBVRG4	SN74LVC1GU04DBVT
SN74LVC1G02DCK3	SN74LVC1G06DCKTE4	SN74LVC1G14DBVR	SN74LVC1G32DBVT	SN74LVC1GU04DCK3
SN74LVC1G02DCK6	SN74LVC1G06DCKTG4	SN74LVC1G14DBVRE4	SN74LVC1G32DBVTE4	SN74LVC1GU04DCKR
SN74LVC1G02DCKR	SN74LVC1G07DBVR	SN74LVC1G14DBVRG4	SN74LVC1G32DBVTG4	SN74LVC1GU04DCKT
SN74LVC1G02DCKRE4	SN74LVC1G07DBVRE4	SN74LVC1G14DBVT	SN74LVC1G32DCK3	

製品表示

この変更に伴い、チップレビジョン、出荷ラベル記載のチップレビジョンが下記のように変更されます。

	チップレビジョン(2P)
現行	A/D/E
変更後	G



図1 出荷ラベル記載箇所の例

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社

信頼性試験

信頼性試験結果

信頼性試験結果					
信頼性試験期間	開始		終了	2011 年 8 月 4 日	
信頼性試験 – 試料構成詳細					
ID:	Device1	Device2	Device3	Device4	
Qual Device:	SN74LVC1G00DCKR	SN74LVC1G02DCKR	SN74LVC1G04DCKR	SN74LVC1G06DCKR	
Wafer Fab Site:	FFAB	FFAB	FFAB	FFAB	
Wafer Process:	50b10.13 BOPO2 / P9792				
Wafer Size:	200 mm Dia.				
Die Coating:	Ti300/TiN1700/AICu0.5=6000/TiN500 Protective Die Coating				
ID:	Device5	Device6	Device7	Device8	
Qual Device:	SN74LVC1G07DCKR	SN74LVC1G08DCKR	SN74LVC1G14DCKR	SN74LVC1G17DCKR	
Wafer Fab Site:	FFAB	FFAB	FFAB	FFAB	
Wafer Process:	50b10.13 BOPO2 / P9792				
Wafer Size:	200 mm Dia.				
Die Coating:	Ti300/TiN1700/AICu0.5=6000/TiN500 Protective Die Coating				
ID:	Device9	Device10	Device11	Device12	
Qual Device:	SN74LVC1G32DCKR	SN74LVC1G34DCKR	SN74LVC1G38DCKR	SN74LVC1GU04DCKR	
Wafer Fab Site:	FFAB	FFAB	FFAB	FFAB	
Wafer Process:	50b10.13 BOPO2 / P9792				
Wafer Size:	200 mm Dia.				
Die Coating:	Ti300/TiN1700/AICu0.5=6000/TiN500 Protective Die Coating				
信頼性試験結果					
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size/ Fails			
		Device1	Device2	Device3	Device4
		Device1	Device2	Device3	Device4
Manufacturability-Assembly	per mfg. Site specification	Approved	-	-	-
X-Ray	Approved by A-T Site	Approved	-	-	-
Electrical Char –LV	Approved by Product Engineer	-	Approved	-	Approved
Manufacturability-TQ	Approved by A-T Site	-	Approved	Approved	Approved
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size/ Fails			
		Device5	Device6	Device7	Device8
		Device5	Device6	Device7	Device8
Electrical Char – LV	Approved by Product Engineer	Approved	Approved	Approved	Approved
Manufacturability-TQ	Approved by A-T Site	Approved	Approved	Approved	Approved
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size/ Fails			
		Device9	Device10	Device11	Device12
		Device9	Device10	Device11	Device12
Electrical Char – LV	Approved by Product Engineer	Approved	Approved	Approved	Approved
Manufacturability-TQ	Approved by A-T Site	Approved	Approved	Approved	Approved

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社

信頼性試験結果					
信頼性試験期間	開始		終了	2011 年 8 月 22 日	
信頼性試験 – 試料構成詳細					
ID:	Device1	Device2	Device3	Device4	
Qual Device:	SN74LVC1G00DBVR	SN74LVC1G02DBVR	SN74LVC1G04DBVR	SN74LVC1G06DBVR	
Wafer Fab Site:	FFAB	FFAB	FFAB	FFAB	
Wafer Process:	50b10.13 BOPO2 / P9792				
Wafer Size:	200 mm Dia.				
Die Coating:	Ti300/TiN1700/AlCu0.5=6000/TiN500 Protective Die Coating				
ID:	Device5	Device6	Device7	Device8	
Qual Device:	SN74LVC1G07DBVR	SN74LVC1G08DBVR	SN74LVC1G14DBVR	SN74LVC1G17DBVR	
Wafer Fab Site:	FFAB	FFAB	FFAB	FFAB	
Wafer Process:	50b10.13 BOPO2 / P9792				
Wafer Size:	200 mm Dia.				
Die Coating:	Ti300/TiN1700/AlCu0.5=6000/TiN500 Protective Die Coating				
ID:	Device9	Device10	Device11	Device12	
Qual Device:	SN74LVC1G32DBVR	SN74LVC1G34DBVR	SN74LVC1G38DBVR	SN74LVC1GU04DBVR	
Wafer Fab Site:	FFAB	FFAB	FFAB	FFAB	
Wafer Process:	50b10.13 BOPO2 / P9792				
Wafer Size:	200 mm Dia.				
Die Coating:	Ti300/TiN1700/AlCu0.5=6000/TiN500 Protective Die Coating				
信頼性試験結果					
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size/ Fails			
		Device1	Device2	Device3	Device4
Electrical Char -LV	Approved by Product Engineer	Approved	Approved	Approved	Approved
Manufacturability- Assembly	per mfg. Site specification	Approved	Approved	Approved	Approved
ESD CDM	1500V	3/0	3/0	3/0	3/0
X-Ray	per AT spec; Bottomside only	5/0	-	-	-
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size/ Fails			
		Device5	Device6	Device7	Device8
Electrical Char –LV	Approved by Product Engineer	Approved	Approved	Approved	Approved
Manufacturability- Assembly	per mfg. Site specification	Approved	Approved	Approved	Approved
ESD CDM	1500V	3/0	3/0	3/0	3/0
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size/ Fails			
		Device9	Device10	Device11	Device12
Electrical Char –LV	Approved by Product Engineer	Approved	Approved	Approved	Approved
Manufacturability- Assembly	per mfg. Site specification	Approved	Approved	Approved	Approved
ESD CDM	1500V	3/0	3/0	3/0	3/0